

< 2018년 정규교육과정 일정안내 >

과정명	월	기간(hr) (교육비)	정원	2 FEB	3 MAR	4 APR	5 MAY	6 JUN	7 JUL	8 AUG	9 SEP	10 OCT	11 NOV	12 DEM
반도체기초	5일(33hr) (₩700,000)	22	19-23 (1차)	12-16 (2차)	9-13 (3차)	14-18 (4차)	18-22 (5차)	변경 후 9-13 (6차)	변경 전 ~~20-24~~ (6차)	변경 전 ~~10-14~~ (7차)	변경 후 10/29-11/2 (7차) 15-19 (8차)	12-16 (9차)	3-7 (10차)	
반도체실무 I	5일(30hr) (₩500,000)	40		26-30 (1차)			25-29 (2차)					19-23 (3차)		
반도체실무II	3일(22hr) (₩350,000)	20			2-4 (1차)							26-28 (2차)		
평판디스플레이	4일(26hr) (₩400,000)	40		5-8 (1차)		8-11 (2차)						10/29-11/1 (3차)		
플라즈마	4일(26hr) (₩400,000)	30		19-22 (1차)		28-31 (2차)				17-20 (3차)				
장비진공	4일(26hr) (₩400,000)	35			23-26 (1차)			2-5 (2차)				22-25 (3차)		
반도체장비통신	3일(20hr) (₩300,000)	30				23-25 (1차)				변경 5-7 (2차)			변경 12-14 (3차)	
Dry Etcher	3일(20hr) (₩300,000)	25			16-18 (1차)							10-12 (2차)		
PECVD/ALD	3일(19hr) (₩300,000)	25				2-4 (1차)							6-8 (2차)	

★ 상기의 일정 및 교육비는 변경 될 수 있음.(1월 정규 교육 없음)

★ [고용노동부-사업주 직업능력개발훈련 지원사업]에 의해 인정 받은 교육과정으로 교육비 일부를 환급.(Ver:18.07)

< 2018년 정규교육과정 접수기간안내 >

안내서 (발송일)	접수기간 (확정통보일)	교육과정 및 기간	정원 (업체별최대인원)
2월 (01.12)	01.15~01.28 (01.29)	반도체기초과정 (1차)	02.19~02.23 22 (4)
3월 (1) (01.26)	01.29~02.11 (02.12)	평판디스플레이과정 (1차)	03.05~03.08 40 (8)
	01.29~02.18 (02.19)	반도체기초과정 (2차)	03.12~03.16 22 (4)
3월 (2) (02.09)	02.12~02.25 (02.26)	플라즈마기술과정 (1차)	03.19~03.22 30 (6)
	02.12~03.04 (03.05)	반도체실무과정 I (1차)	03.26~03.30 40 (8)
4월 (1) (02.23)	02.26~03.11 (03.12)	반도체실무과정 II (1차)	04.02~04.04 20 (4)
	02.26~03.18 (03.19)	반도체기초과정 (3차)	04.09~04.13 22 (4)
4월 (2) (03.09)	03.12~03.25 (03.26)	Dry Etcher기술과정 (1차)	04.16~04.18 25 (5)
	03.12~04.01 (04.02)	장비진공기술과정 (1차)	04.23~04.26 35 (7)
5월 (1) (03.23)	03.26~04.08 (04.09)	PECVD/ALD기술과정 (1차)	05.02~05.04 25 (5)
	03.26~04.15 (04.16)	평판디스플레이과정 (2차)	05.08~05.11 40 (8)
	04.09~04.22 (04.23)	반도체기초과정 (4차)	05.14~05.18 22 (4)
5월 (2) (04.06)	04.09~04.29 (04.30)	반도체장비통신기술과정 (1차)	05.23~05.25 30 (6)
	04.09~05.07 (05.08)	플라즈마기술과정 (2차)	05.28~05.31 30 (6)
6월 (05.11)	05.14~05.27 (05.28)	반도체기초과정 (5차)	06.18~06.22 22 (4)
	05.14~06.03 (06.04)	반도체실무과정 I (2차)	06.25~06.29 40 (8)
7월 (1) (05.25)	05.28~06.10 (06.11)	장비진공기술과정 (2차)	07.02~07.05 35 (7)
7월 (2) (06.05)	06.05~06.20 (06.21)	*변경 후* 반도체기초과정 (6차)	07.09~07.13 22 (4)
8월 (07.13)	07.16~07.29 (07.30)	~~*변경 전* 반도체기초과정 (6차)~~	<del>08.20~08.24</del> 22 (4)
	07.30~08.12 (08.13)	*변경* 반도체장비통신기술과정 (2차)	09.05~09.07 30 (6)
9월 (07.27)	07.30~08.19 (08.20)	~~*변경 전* 반도체기초과정 (7차)~~	<del>09.10~09.14</del> 22 (4)
	07.30~08.26 (08.27)	플라즈마기술과정 (3차)	09.17~09.20 30 (6)
10월 (1) (08.31)	09.03~09.16 (09.17)	Dry Etcher기술과정 (2차)	10.10~10.12 25 (5)
	09.03~09.20 (09.21)	반도체기초과정 (8차)	10.15~10.19 22 (4)
10월 (2) (09.14)	09.17~09.30 (10.01)	장비진공기술과정 (3차)	10.22~10.25 35 (7)
	09.17~10.07 (10.08)	평판디스플레이과정 (3차)	10.29~11.01 40 (8)
	09.17~10.07 (10.08)	*변경 후* 반도체기초과정 (7차)	10.29~11.02 22 (4)
11월 (1) (09.28)	10.01~10.14 (10.15)	PECVD/ALD기술과정 (2차)	11.06~11.08 25 (5)
	10.01~10.21 (10.22)	반도체기초과정 (9차)	11.12~11.16 22 (4)
11월 (2) (10.12)	10.15~10.28 (10.29)	반도체실무과정 I (3차)	11.19~11.23 40 (8)
	10.15~11.04 (11.05)	반도체실무과정 II (2차)	11.26~11.28 20 (4)
	10.29~11.11 (11.12)	반도체기초과정 (10차)	12.03~12.07 22 (4)
12월 (10.26)	10.29~11.18 (11.19)	*변경* 반도체장비통신기술과정 (3차)	12.12~12.14 30 (6)

★ 접수기간은 교육 실시 5주전부터 3주전까지이고, 선착순으로 이루어집니다.

★ 과정별 정원에 따라 업체별 최대수강인원이 제한됩니다.